

考える、選ぶ、創り出す テクニカルコーディネーター

■会社概要及び当社の特長

(speaker: 代表取締役 大塚真治)

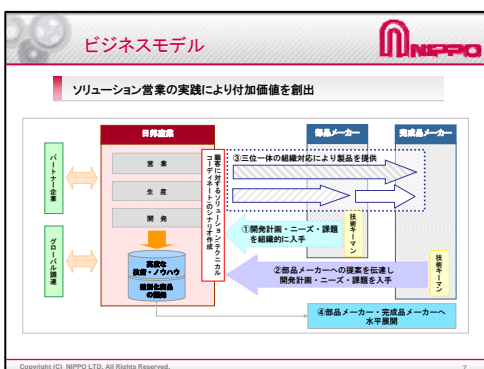
当社は「考える、選ぶ、創り出すテクニカルコーディネーター」の事業理念のもと、メーカー機能を持った工業部品・産業資材の専門商社として、お客様の顕在化した潜在ニーズを考え、発掘し、最適な素材と加工方法を選び、地球環境に配慮した高品質な材料、部品、ユニット、製品、サービスを作り出すグローバルソリューション企業を目指している。

事業構成は2007年3月期より、今まで地域別だった組織を、技術営業の強化、マーケットへの深耕を目的に「商事事業本部」「自動車部品事業本部」「半導体液晶機器事業本部」「メカトロ事業本部」「開発技術本部」へ変更しており、部門別売上構成比は、商事事業本部(46%)の割合が大きいものの、今後、自動車部品事業本部(23%)、半導体液晶機器事業本部(6%)、メカトロ事業本部(25%)にも注力をしていく考えである。

尚、取扱製品を主体とした事業のセグメント区分は、産業資材関連事業(66%)・プラスチック成形品関連事業(30%)・その他事業(4%)であり、国内(74%)・海外(26%)の売上構成比となっている。製品については、メーカー機能となる自社工場の製品である「射出成形品」をはじめ多岐に渡っており、材料から部品、ユニット、完成品まで、その種類は約30,000アイテムとなる。



また、国内ネットワークは、北は東北営業所(仙台市)から、南は九州営業所(福岡市)まで8ヶ所の営業網を設け、メーカーとして2ヶ所の生産拠点で精密プラスチック部品のニーズに対応している。海外ネットワークは、1987年にバンコク工場と台北支店を開設して以来、お客様のニーズへの対応をはかり、メカトロニクスカンパニーとして中国および東南アジアへ拡大している。取引先の海外進出に伴い、ビジネスパートナーとして製品を供給し、現地顧客のニーズを敏感に察知し、迅速に対応できるサポート体制を構築、現在は、生産拠点5ヶ所、営業拠点5ヶ所で展開している。



当社のビジネスモデルは営業スタイルとして、お客様、特に技術キーマンからの情報を伺い、時には情報を引き出し、その情報を基に、営業、生産、開発の三位一体、更に仕入先を加えた四位一体で対応し、お客様に喜んで頂ける製品を提案し受注する、つまり技術営業サービスとして付加価値を提供するところにある。

ビジネスモデルを達成できる当社の特長として挙げられる要素の1つは、多彩な視点とノウハウで試作から量産までサポートできる所であり、お客様への対応フローとして、お客様のニーズをもとに、企画段階から開発、製造までを当

社の開発部門、営業部門、生産部門にてトータル的なサポートを実施しているところにある。販売先は、日本有数の大手メーカーを含み多岐に及んでいることから、限られたお客様の業績には大きく影響を受け難いという特長も有している。もう一つの特長は、優れた開発力や加工技術を有している多種多様なパートナーとのネットワークを構築しているところであり、お客様の様々なニーズに対してパートナーの技術を活用、コーディネートし対応できることである。

■2008年3月期 決算概要 及び 2009年3月期 業績予想

(speaker: 常務取締役 笹倉健一郎)

2008年3月期は売上高430億23百万円(前期比106.4%)・営業利益14億75百万円(同130.2%)と順調に推移した。

売上高は自動車部品、半導体液晶機器、メカトロ各事業の売上の伸びを受け、特に自動車部品ではエンジンマネージメント系製品、半導体では前工程製造プロセスの製造部材、メカトロでは自動車部品および携帯電話向けフレキシブルプリント配線板が好調であった。

営業利益は、第4四半期に入り原油価格の高騰に伴う製造原価の上昇や半導体の在庫調整などの影響を受け伸びが鈍化した。通期では稲沢工場が期首から安定的に生産を行い、稼働率および生産性が大幅に向上したこと。また、昨年度増設、拡張したタイのコラート工場において電子デバイス関連部品の生産の開始も収益性改善の要因となった。

経常利益については13億51百万円(同85.7%)と前年比を下回った。主な要因は、売上増加に伴う販管費の増加、為替差損益であり、2007年3月期は為替差益が約3億70百万あったが、2008年3月期は為替差損が約1億80百万発生したことによるものである。

当期純利益については11億15百万円(同81.0%)と前年比を下回った。主な要因は、税効果会計による引当の積み増しである。

事業本部別では、商事事業本部が売上高200億7百万円(同101.0%)、売上総利益21億93百万円(同98.7%)となった。このうちRFID事業部の売上高5億35百万円(同99.4%)、売上総利益37百万円(同113.3%)となっている。自動車部品事業本部は売上高97億10百万円(同119.2%)、売上総利益15億33百万円(同129.5%)、半導体液晶機器事業本部は売上高25億52百万円(同124.4%)、売上総利益5億7百万円(同121.1%)、メカトロ事業本部は売上高107億53百万円(同103.2%)、売上総利益15億12百万円(同107.0%)となった。

商事事業本部については、電子デバイス関連商品の売上好調も、商材の海外移管が進み売上の伸びが小さくなった。RFID事業部については、アパレル業界とアミューズメント業界の不況による普及の遅れで低迷し、ソリューション提案件数については増えているものの、まだまだコスト面やシステム、ソフト並びに周辺機器の技術面の課題が多く、普及段階には至っていないと判断している。

自動車部品事業本部については、自動車の電子化に伴う、電子制御・可変バルブ機構などエンジンマネージメント系製品が前年比30%程度伸びた。中でも当社のマグネットインサート成形の技術を生かして生産したセンサー機能をもつ成形品が好調であった。また、環境性能向上すなわちエンジンの燃費向上のための電子化に伴う様々な部品の開発を樹脂で提案しており、当社の業績拡大に大きく寄与している。

半導体液晶機器事業本部については、デバイスメーカーの投資が積極的に行われている前工程製造プロセスの製造装置用部材において、ダイヤモンド工具、シリコン部品の売上が拡大し、前年比30%程度伸びている。

メカトロ事業本部については、ベトナムにおけるプリンター関連部品の落ち込みがあったが、タイにおける自動車部品および携帯電話向けフレキシブルプリント配線板が好調に推移した。昨年度増設、拡張したタイのコラート工場におけるデジタル製品の組み立てが増加要因として大きく寄与している。

2008年3月期 業績ハイライト



(単位:百万円・百万円未満切捨て)

科目	2007年3月期			2008年3月期		
	構成比	前期比	期初計画比	構成比	前期比	期初計画比
売上高	40,419	100.0	108.1	43,023	100.0	106.4
営業利益	1,133	2.8	110.3	1,475	3.4	130.2
経常利益	1,577	3.9	134.2	1,351	3.1	85.7
当期純利益	1,377	3.4	100.0	1,115	2.6	81.0
EPS	166.68円		90.4	123.58円		74.1
1株当たり配当金	20.00円		133.3	20.00円		100.0

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved.

13

事業本部別業績 売上高・売上総利益



【事業本部別売上高】 (単位:百万円・百万円未満切捨て)

事業部門	2007年3月期			2008年3月期		
	構成比	前年同期比	期初計画比	構成比	前年同期比	期初計画比
商事事業本部	19,800	49.0	96.7	20,007	46.5	101.0
RFID事業部	538	1.3	67.3	535	1.2	99.4
自動車部品事業本部	8,145	20.1	123.2	9,710	22.6	119.2
半導体液晶機器事業本部	2,051	5.1	121.7	2,552	5.9	124.4
メカトロ事業本部	10,421	25.8	128.7	10,753	25.0	103.2
計	40,419	100.0	108.1	43,023	100.0	106.4

【事業本部別売上総利益】 (単位:百万円・百万円未満切捨て)

事業部門	2007年3月期			2008年3月期		
	構成比	前年同期比	期初計画比	構成比	前年同期比	期初計画比
商事事業本部	2,222	42.4	97.4	2,193	38.2	98.7
RFID事業部	32	0.6	79.2	37	0.6	113.3
自動車部品事業本部	1,184	22.6	112.9	1,533	26.7	129.5
半導体液晶機器事業本部	419	8.0	133.8	507	8.8	121.1
メカトロ事業本部	1,413	27.0	122.7	1,512	26.3	107.0
計	5,240	100.0	104.5	5,747	100.0	109.7

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved.

13

2009年3月期業績予想



■ 損益計算書 (単位:百万円・百万円未満切捨て)

科目	2008年3月期実績			2009年3月期予想		
	構成比	前期同期比	期初計画比	構成比	前期同期比	期初計画比
売上高	43,023	100.0	106.4	43,000	100.0	99.9
営業利益	1,475	3.4	130.2	1,350	3.1	91.5
経常利益	1,351	3.1	85.7	1,200	2.8	88.8
当期純利益	1,115	2.6	81.0	750	1.7	67.2

■ 事業本部別売上高 (単位:百万円・百万円未満切捨て)

事業部門	2008年3月期実績			2009年3月期予想		
	構成比	前期同期比	期初計画比	構成比	前期同期比	期初計画比
商事事業本部	20,007	46.5	101.0	21,700	50.5	108.0
RFID事業部	535	1.2	99.4	700	1.6	131.0
自動車部品事業本部	9,710	22.6	119.2	8,500	19.8	88.0
半導体液晶機器事業本部	2,552	5.9	124.4	2,800	6.5	110.0
メカトロ事業本部	10,753	25.0	103.2	10,000	23.2	93.0
計	43,023	100.0	106.4	43,000	100.0	100.0

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved.

24

2009年3月期の業績予想については、サブプライム問題を契機とした米国経済の後退に伴う自動車業界・OA機器業界・半導体業界の動向を分析し、景気後退・原価の上昇・為替などの影響により売上高430億円(前期比99.9%)、営業利益13億5000万円(同91.5%)、経常利益12億(同88.8%)、当期純利益7億5000万円(同67.2%)と減収減益を予想している。

■ 今後の展望

(speaker: 代表取締役 大塚眞治)

当社は、2011年3月期に年商500億円、経常利益25億円を数値目標とした中期経営計画を策定し、実行中である。

主な全社戦略としては、

- ① 付加価値提案ビジネスの推進
- ② ビジネスパートナー戦略
- ③ 自動車部品生産体制の強化
- ④ 品質保証体制の整備
- ⑤ 国内外ビジネスの連携強化
- ⑥ 経営効率の向上

を掲げている。

売上高については、自動車事業本部を除き、全ての事業部で伸張すると考えており、特に半導体液晶機器事業本部は、2008年3月期に対して184%を目標にしている。自動車部品は、エンジン駆動関連部品の商流変更および海外移管が売上を減少する主要因となるものの、海外移管先については、メカトロ事業本部の海外生産拠点をベトナムに決定しており、グループ全体としては、2008年3月期に対して116.2%を計画している。

売上総利益については、売上高が減少する自動車部品事業本部についても、生産性の改善などにより2008年3月期と同等の利益を確保し、日邦グループ全体としては、2008年3月期に対して126%を計画している。

各事業本部の事業環境については、現在、サブプライムローン問題による金融市場の混乱や、原油価格の高騰による景気減速、消費マインドの低下が予想されているが、このような面では、中長期的には落ち着いてくると考えている。商事事業、自動車部品事業、半導体液晶機器事業、メカトロ事業の各事業環境においては、更に加速すると思われる『グローバル化』、今後、世界規模の問題として取り組まなければならない『環境問題』『エネルギー問題』といったことが、大きなポイ

ントになる。こうした事業環境において、当社は事業機会を発掘し、如何にピンチをチャンスに替えていくか、当社の目指す「グローバルソリューションカンパニー」としての真価を問われる、そういった試練の時期であると感じている。

各事業本部の基本方針及び具体的施策は次の通りである。

商事事業本部において特にポイントとなるのは、電子材料化学業界で売上規模および技術面でもトップクラスの日立化成工業の特約店として、新材料開発の提案、用途開発を進めると同時に、当社の成形技術と当社のビジネスパートナーとの連携により新商品の開発を行い、販売力を強化していくことである。また、当社が進めている受託設計、試作ソリューションを展開し、お客様の設計部門との関係性を強化することで、商品の開発段階から携わり、新たなニーズの発掘と拡販を推進していく。

商事事業本部はカテゴリーを電子デバイス関連、OA・DI関連、住宅関連、その他の4つに分類している。2009年3月期の売上高は、全体で約210億円を予想し、最終的な中期計画である2011年3月期には約234億円を目標している。また、今年度より営業力の強化として商事事業本部内に開発室を設置した。

商事事業本部の中で注力している「RFID事業」では、基本方針として、当社最大のビジネスパートナーである日立化成工業および日立製作所製のICカード、タグ、 μ チップをコアとし、システムハウスとのコラボレーションによる周辺機器、運用システムの開発に取り込み、RFID事業を当社の中核事業として拡大することとしている。具体的施策としては、日立化成工業および日立製作所製のタグを主体として、更に付加価値を高める為、専任集中化によってより詳細な情報を入手すると同時に、市場、お客様からの要求テーマに対して、ビジネスパートナーの技術と当社の成形技術、開発技術を加えた共同開発商品の提案、販売を行う独自の商流を確保すると共に、差別化を図っていく。

商事事業本部RFID事業部のカテゴリーはアミューズメント関連、オフィス・製造関連、流通関連、その他の4つに分類している。2009年3月期の売上高は、全体で約7億円を予想し、最終的な中期計画である2011年3月期にはアミューズメント関連、オフィス・製造関連が大きく伸びると予想し、約19億円を目標としている。

自動車部品事業本部は、自動車業界のTier1メーカーに対し電子制御系部品を中心に事業展開している。世界の主要自動車メーカーは持続成長を可能にするために、自動車の需要が確実に拡大するBRICsやLCCへの投資を積極的に進め、年間平均伸張率は5%~6%程度であると認識しており、その様な状況において当社はテクニカルコーディネーターとして、他社が今まで取り組んでいない分野へ挑戦していく事が必要と考えている。

具体的施策としては、特に2008年以降の環境性能向上に対応したエンジンマネジメント系製品において、当社の成形技術と開発技術を活用した製品開発と生産技術力によって安定した品質の製品

商事事業本部

重点顧客への営業強化とソリューションビジネスの構築

事業の基本方針

- ① 重点顧客への更なるワンストップサービスを提供
- ② 材料メーカーとの技術提携によるコラボレーション
- ③ ソリューションビジネスの確立

具体的施策

- ① エレクトロニクス分野に対し日立グループ製品を中心に販売
- ② 電子デバイスメーカーに対し新商品の拡販
- ③ 受託設計・試作ソリューションビジネスを展開し、新たなニーズの発掘及び拡販
- ④ 主要顧客の海外活動支援を行い海外ビジネスの拡大

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved. 30

商事事業本部 RFID事業

付加価値の向上、ターゲット市場の選択と集中を行い事業基盤を構築する

事業の基本方針

ICカード、タグ、 μ チップをコアとし、周辺機器、運用システムを取り込み、RFID事業を当社の中核事業として拡大

具体的施策

- ① 日立化成工業、日立製作所(情ST)への専任集中化による関係性強化
- ② システムハウスとのコラボレーションによりシステムユニットの販売を強化
- ③ 提案営業の推進

※日立製作所(情ST)とは、株式会社日立製作所 セキュリティ・トレーサビリティ事業部です。

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved. 32

自動車部品事業本部

選択と集中を更に強化し、テクニカルコーディネーターとしての役割を発揮

事業の基本方針

- ① 当社独自の成形技術を活かし、高付加価値商品の創出に注力
- ② 安全走行、電子制御系の自動車部品に特化し、他社との差別化を図り、プロモントメーカーを目指す

具体的施策

- ① 2008年以降の環境性能向上に対応した機構改変モデルへの取り組みを強化
- ② 高度な技術と信頼できる生産体制を持つビジネスパートナーの開拓
- ③ 設備総合効率の向上
- ④ 教育訓練の強化

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved. 34

を提供することで、売上の拡大を図っていききたいと考えている。また、今まで培ってきた技術力、新たなビジネスパートナーとの協業により、生産技術力を向上させていきたい。

自動車部品事業本部はカテゴリーをエンジン駆動関連、センサー制御関連、燃料ポンプ関連、モーター周辺関連、その他の5つに分類している。2009年3月期の売上高は、環境性能、燃費向上に対応した自動車の電子化に伴い、エンジン駆動関連部品は順調に推移する予定であるが、一部製品の商流変更に伴い売上高は85億円を予想している。

半導体液晶機器事業本部では、現在、投資が拡大している12インチの先端プロセス工場と業界トップ8社に対して、最適部材を提供することで売上の拡大を図っていききたいと考えている。また、後工程をメインとした日本のデバイスメーカーの海外進出に伴い、当社も海外での営業基盤を構築し、2010年には年商5億円規模の海外ビジネスへ成長させていく。更に、2007年度、安定性を向上させた自社商品の半導体製造装置用故障診断システム(RISe)を先端プロセス工場や装置メーカーに対して積極的な販売活動を行い、売上2億円規模のビジネスを実現したいと考えている。

半導体液晶機器事業本部はカテゴリーを製造装置用部材、プロセス周辺機材、新規仕入商品、半導体プロセス用ソフトウェアの4つに分類しており、2009年3月期の売上高は全体で約28億円を予想しており、2011年3月期の売上高は47億円を目標としている。

メカトロ事業本部では、自動車部品についてはタイを中心としたエンジン部品の海外生産シフトに集中営業を行い、当社の海外生産拠点を活用して客先工程を内製化することで、Tier1メーカーへの更なる深耕を図りたいと考えている。また、OA・DIビジネスにおいては、クリーンルームを設置したタイのコラート工場を活用し一貫体制にて進めていく。

メカトロ事業本部はカテゴリーをOA・DI関連、車載部品関連、電子デバイス関連、金型関連の4つに分類しており、2009年3月期の売上高は全体で約100億円を予想し、2011年3月期の売上高は全体で約118億円を目標としている。

最後に、今後の優先課題としては、特に半導体関連および金属加工関連でのM&Aという形を実現して、半導体事業関連での商品レパトリーを拡大し、加工技術についてもさらに特化していき、最終的に2011年3月期の売上高500億・経常利益25億を達成したいと考えている。

半導体液晶機器事業本部

重点顧客への販売力強化と戦略商品の育成

事業の基本方針

- ① 市場の激変に対応した顧客・製品の選択と集中
- ② 事業領域の強化

具体的施策

- ① 投資が集中している先端プロセスへの拡販強化
- ② 業界トップ8社への重点攻略と、攻めきれていない事業領域への販売強化
- ③ 海外展開の基盤構築
- ④ 自社商品である半導体装置用故障診断システム(RISe)の拡販

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved. 36

メカトロ事業本部

海外の成長マーケットにおいて、競争力を強化

事業の基本方針

- ① 海外の成長マーケットに即した競争力を強化し、マネジメント、技術、生産体制をセグメントごとに構築
- ② 現地で優秀な人材の確保、育成を行う

具体的施策

- ① 自動車部品(Tier1)メーカーへの更なる深耕
- ② OA・DIビジネスの高付加価値品へのシフト
- ③ 工場の標準化と改善活動(実践道場)の推進
- ④ アジア営業ネットワークの構築

Copyright (C) NIPPO LTD. All Rights Reserved. 38

(2008. 6.10 大手町サンケイプラザにて)